製品仕様書

Specification of Crystal Unit

決定年月日 Issue Date : September 30, 2024

1. 品番 Part Number

当 社 品 番 Murata Part Number

XRCGE32M000MXF1LR0

(Frequency: 32.0000MHz / Size: 2.0 x 1.6mm)

|2. 適 用 Scope

当製品仕様書は、車載用マイクロコンピュータ等のクロック発生回路に使用する水晶振動子について規定します。この用途以外にご使用の場合には事前に当社へご連絡ください。

This product specification is applied to the crystal unit used for time base oscillator in a microcomputer for automotive. Please contact us when using this product for any other applications than described in the above.

3. 外観 及び 寸法 Appearance and Dimensions

3-1 外観: 目視によって表示識別可能であり、汚れ等がありません。

Appearance : No illegible marking. No visible dirt.

3-2 外形寸法図 : 製品単体の形状を項目6に示します。

Dimensions of component : Please refer to item 6 for component dimensions.

3-3 構造 : アルミナ基板に、水晶素子を接着し、金属キャップで蓋

をしております。

Construction : Crystal element is mounted onto alumina substrate,

then metal cap covers over the element.

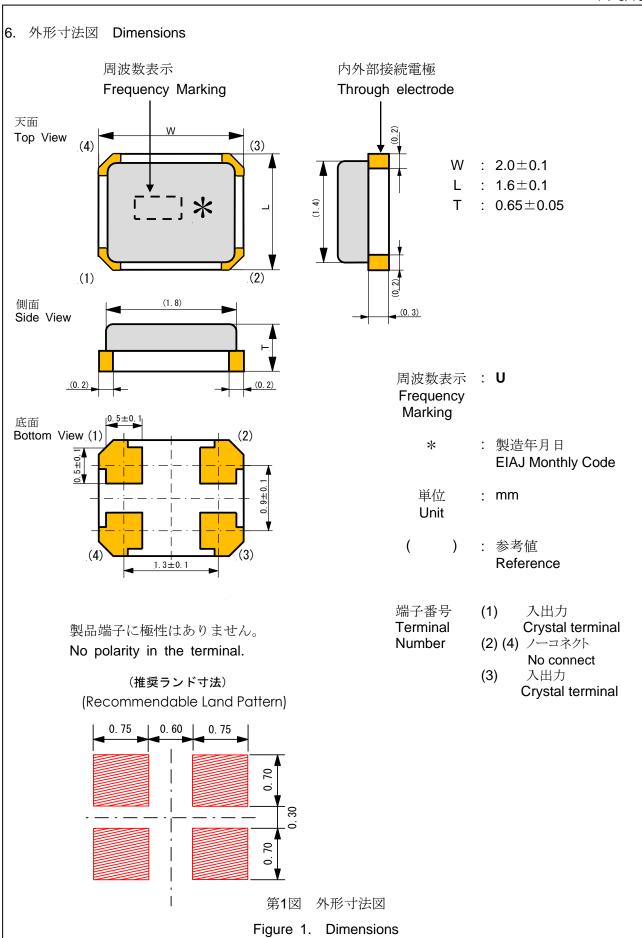
4. 定格 Rating

	Rating			
	項 目 Item	規格 Specification		
4-1	動作温度範囲	40 to 1425°C		
	Operating Temperature Range	-40 to +125°C		
4-2	保存温度範囲	FF to 1125°C		
	Storage Temperature Range	-55 to +125°C		
4-3	励振レベル	200 MINT/may		
	Drive Level	300 μ W以下/max.		
4-4	直流印加電圧	D C 6V N 5/max		
	D.C. Voltage	D.C.6V 以下/max.		
4-5	入力信号振幅	15Vp-p 以下/max.		
	A.C. Voltage			
4-6	耐電圧	D.C.100V 以下/max.		
	Withstanding Voltage	5s 以内/max.		

5. 電気的性能 Electrical Characteristics

- 単メに	が注形 Electrical Characteristics				
	項 目 Item	規格 Specification			
5-1	公称周波数	32.0000MHz			
	Nominal Frequency	32.0000ivii iz			
5-2	総合周波数許容偏差 (以下の項目を含む)				
	Total Frequency Tolerance (including the following items)				
	・周波数許容偏差(+25°C) *1				
	Frequency Tolerance(+25°C) *1				
	・周波数温度依存性(-40 to +125°C) *1	_			
	(+25° ℃の値に対して)	±40ppm以内/max.			
	Frequency Shift by Temperature(-40 to +125°C) *1				
	(from initial value at +25°C)				
	・周波数エージング (+25˚C 、15year(s))(初期値に対して)				
	Frequency aging(+25° C、15year(s)) (from initial value)				
5-3	等価直列抵抗 *1	1000 N∑/may			
	Equivalent Series Resistance *1	100Ω 以下/max.			
5-4	絶縁抵抗 *2	500MΩ 以上/min.			
	Insulation Resistance *2 (D.C.10V 印加時)				
		(Applied D.C.10V)			
5-5	負荷容量 (Cs)	7.0pF			
	Load Capacitance	γ.υρι			

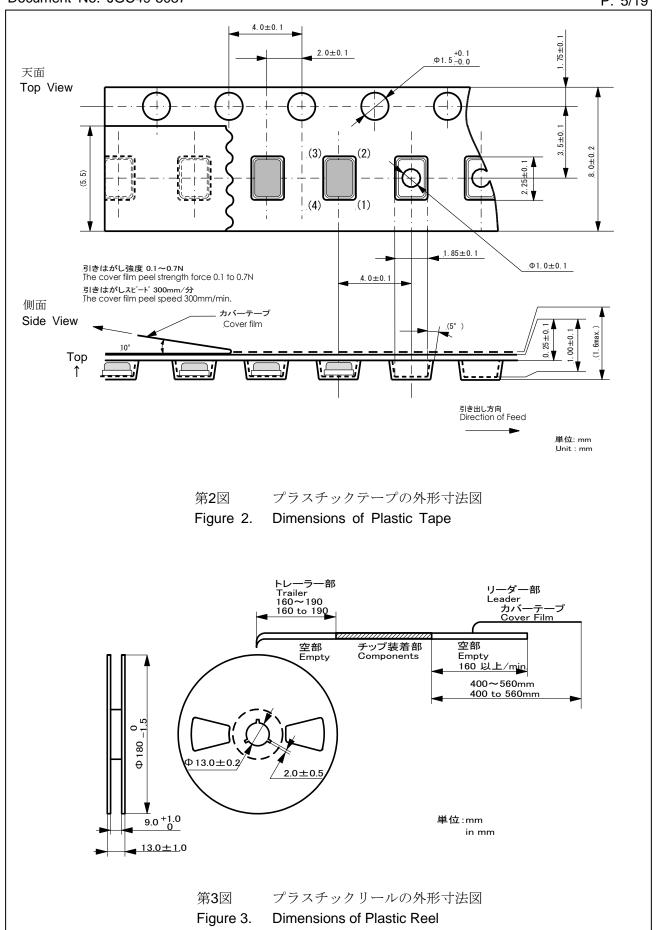
- *1 周波数および等価直列抵抗の測定方法は項目8を参照ください。 Please refer to item 8 for measuring method of frequency and Equivalent Series Resistance.
- *2 端子相互間での抵抗を示します。
 This characteristic shows the resistance between terminals.



	月 Month												
年 Year	力 MOIItii	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2011, 2015, 2019,	2023	a	b	$\overline{\mathbf{c}}$	d	е	f	g	h	j	k	ℓ	m
2012, 2016, 2020,	2024	n	p	B	r	Q	t	u	v	w	x	¥	3
2013, 2017, 2021,	2025	Α	В	O	D	E	F	Ġ	Н	J	K	L	M
2014, 2018, 2022,	2026	Ν	P	Ø	R	s	Т	U	V	w	X	Y	Z

製造年月度 / EIAJ Monthly Code

- (注) 4年で1サイクルとなります。 / (note) The number is cycled by 4years.
- 7. テーピング品包装規格 Packaging Standard (Taping)
 - 7-1 テープは右巻き(テープの端を手前に取り出した時、送り穴が右側になる向き)とします。 The tape for components shall be wound clockwise. The feeding holes shall be to the right side as the tape is pulled toward the user.
 - 7-2 チップは、1リール 3,000個収納します。 A reel shall contain 3,000pcs of components.
 - **7-3** プラスチックテープの外形寸法図を第2図に示します。 Dimensions of plastic tape are shown in Figure 2.
 - **7-4** プラスチックリールの外形寸法図を第3図に示します。 Dimensions of plastic reel are shown in Figure 3.



株式会社 村 田 製 作 所 Murata Manufacturing Co.,Ltd.

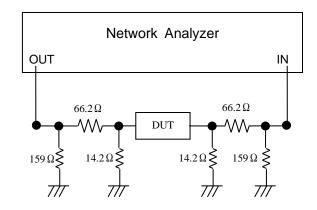
8. 測定方法 Measuring Method

8-1 周波数測定方法:

5、9、10項で示す周波数は、第4-1図で示す回路とネットワークアナライザ(S&A 250Bもしくは相当品)にて測定した負荷共振周波数を示します。測定機器の違いにより、周波数ズレが発生する可能性があります。

Frequency measuring method:

Frequency which is mentioned in item 5, 9 and 10 means the load resonance frequency measured by network analyzer (S&A 250B or the equivalent) and the circuit in Figure. 4-1. Measured frequency may be changed by using different measurement equipment.



第4-1図 周波数測定回路

Figure 4-1 Frequency measuring circuit

8-2 等価直列抵抗 : 5項に示す等価直列抵抗(ESR)は、第4-1図で示す回路と

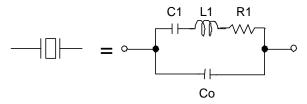
ネットワークアナライザ(S&A 250Bもしくは相当品)に

て測定します。DUTは第4-2図に示します。

Equivalent series resistance : The equivalent series resistance (ESR) which is men-

tioned in item 5 is measured by network analyzer (S&A 250B or equivalent) and the circuit in Figure. 4-1. DUT is

shown in Figure 4-2.



第4-2図 DUT(被測定デバイス) Figure 4-2 DUT(Device Under Test)

8-3 測定条件: 温度+25±3°C、湿度25~75%R.H.を標準測定状態とします。

Measuring Condition : Standard conditions for the measurement shall be

+25±3°C temperature and the humidity of 25 to 75%R.H.

9. 機械的性能 Physical Characteristics

1及7人口:	性能 Physical	Characteristics	
	項目	試 験 条 件	試験後の規格
	Îtem	Test Condition	Specification
			After Test
9-1	衝擊	製品を試験用基板に実装した状態で、加速度	
		100G(980m/s²)、作用時間6msの衝撃を6面に各3回	
		加えた後、測定します。試験方法はAEC-Q200 REV	
		Dに準拠します。	The measured values
	Mechanical	Component shall be soldered on the test board.	
	Shock	Then it shall be measured after being applied 3	
		successive shocks, 100G(980m/s²) for 6ms in the	
		directions of 6 sides. Testing procedure is in	
		accordance with AEC-Q200 REV D.	
9-2	振動	製品を試験用基板に実装した状態で、振動周波数	表1を満足します。
		10~2000Hz、5G(49m/s²)の振動をX,Y,Zの3方向に	
		各4時間加えた後、測定します。試験方法はAEC-	
		Q200 REV Dに準拠します。	The measured values
	Vibration	Component shall be soldered on the test board.	shall meet Table 1.
		Then it shall be measured after being applied	
		vibration of 5G(49m/s ²) with 10 to 2000Hz band of	
		vibration frequency to each of 3 perpendicular	
		direction for 4 hours. Testing procedure is in	
		accordance with AEC-Q200 REV D.	
9-3	基板たわみ	第 5 図に示すたわみ試験用基板に実装し、たわみ量	表1を満足します。
		2mm になるまで毎秒 0.5mm の速さで加圧し、60+5/-	
		0 秒間保持します。 試験方法は AEC-Q200 REV D に	
		準拠します。	The measured values
	Board Flex	Component shall be soldered on the test board	
		shown in Figure 5. Then apply pressure in vertical	
		direction shown in following figure at a rate of	
		about 0.5mm/s until bent width reaches 2mm and	
		hold for 60+5/-0 seconds. Testing procedure is in	
		accordance with AEC-Q200 REV D.	
		加圧棒	
		20 ^{Stick} 10 Load	
		PCB	
		たわみ Deflection	
		45+#6	
		φ 5支持台 φ 5 Supporter 部品 Part J to 26-ズレ Part Off-Center	
		45 45	
		,	

株式会社 村 田 製 作 所 Murata Manufacturing Co.,Ltd.

9-4	はんだ耐熱	製品単品状態でリフロー炉(ピーク温度 260±5℃、	表1を満足します。
	Resistance to	1.0±0.5 秒、その他条件は 12-5-2 項を参照)に 2 回	
	Soldering Heat	通した後、室温に取り出し、24 時間放置した後、測定	
	(1)リフロー方式	します。 試験方法は IEC60068-2-58 に準拠します。	The measured value
	(1)Re-flow	Component shall be measured after 2 times re-	shall meet Table 1
	Soldering	flow soldering and leaving at room temperature for	
		24 hours. For soldering profile, refer to item 12-5-2	
		(Peak temperature is 260±5°C for 1.0±0.5s).	
		Testing procedure is in accordance with	
		IEC60068-2-58.	
	(2)コテ付け方式	PCB上にて温度+350±5℃で5.0±0.5秒間はんだ付	外観に異常がなく、表
		けを行い、室温に24時間放置した後、測定します。但	を満足します。
		し、はんだこて先は電極部に直接接触しない事としま	
		す。試験方法はIEC60068-2-58に準拠します。(12-5-	
		3項を参照)	No visible damaç
	(2)Soldering	Component shall be measured after soldering on	and the measure
	with iron	PCB at +350±5°C for 5.0±0.5s and leaving at room	values shall me
		temperature for 24 hours. The soldering iron shall	Table 1.
		not touch the component while soldering. Testing	
		procedure is accordance with IEC60068-2-58.	
		(Refer to item 12-5-3)	
	(3)はんだディッ	製品端子部を+260±5°Cの溶融はんだ中に10±1秒	表 1 を満足します。
	プ方式	間浸した後、室温に取り出し、24時間放置した後、測	
		定します。試験方法はJESD22-B106に準拠します。	The measured value
	(3)Solder Dip	The terminals of component shall be immersed in	
		a soldering bath at +260±5°C for 10±1s by only to	
		level to cover. Component shall be measured after	
		leaving at room temperature for 24 hours. Testing	
		procedure is in accordance with JESD22-B106.	

9-5	はんだ付性	無鉛はんだ (Sn-3.0Ag-0.5Cu)	端子の95%以上にはん
		PCT装置にて温度+105℃、湿度100%R.H.、4時間の	だが付着します。
		エージングをし、端子部分をロジンメタノール液に5秒	
		浸した後、+245±5℃の溶融はんだ中に3±0.5秒間浸	
		します。試験方法はIEC60068-2-58に準拠します。	
	Solderability	Lead free solder (Sn-3.0Ag-0.5Cu)	The solder shall coa
		After being kept in pressure cooker at +105°C	at least over ninety
		and 100%R.H. for 4 hours, and being placed in a	five (95) % of the
		rosin-methanol for 5s, the terminals of component	terminal surface.
		shall be immersed in a soldering bath at +245±5°C	
		for 3±0.5s. Testing procedure is accordance with	
		IEC60068-2-58.	
	はんだ付性 (2)	PCT装置にて温度+105℃、湿度100%R.H.、4時間の	其指側声電攝 1//+1
	(よん/こ刊 注(2)	エージングをし、第1図に示す当社推奨ランドに実装し	
		ます。実装条件は12-5-1、12-5-2項に従います。	上しなんしたが一面をしまり。
		After being kept in pressure cooker at +105°C	The colder shall wet a
	Solderability(2)	and 100%R.H. for 4 hours, component shall be	
	Solder ability(2)	mounted on recommended land pattern shown in	
		Figure 1. For soldering conditions and profile, refer	,
		to item 12-5-1 and 12-5-2.	substrate.)
		10 hem 12-5-1 and 12-5-2.	Substrate.)
9-6	固着強度	R0.5の引っかき治具を使用して、矢印の方向に17.6N	表1を満足します。
		の静荷重を加えて60秒間保持します。試験方法は	
		AEC-Q200 REV Dに準拠します。	The measured values
	Terminal	Component shall be soldered on the test PCB.	
	Strength	Then a static load of 17.6N using a R 0.5 scratch	
		tool shall be applied on the core of the component	
		and in the direction of the arrow and held for	
		60s. Testing procedure is in accordance with AEC-	
		Q200 REV D.	
		Scratch tool 引っかき治具 Chip	
		<u></u>	
		Chip チップ	

10. 耐候性能 Environmental Characteristics

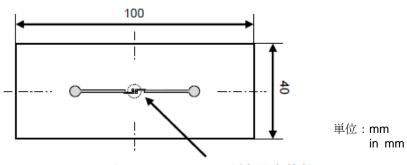
	項目	試 験 条 件	試験後の規格
	Item	Test Condition	Specification
10.1	之知 北. 四	#1日 2 3 4 6 日 甘 1 1 2 1 7 7 7 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7	After Test
10-1	高温放置	製品を試験用基板に実装した状態で、温度+125℃	
		の恒温槽中に1000時間保持した後、室温に取り出	
		し、24時間放置した後、測定します。試験方法は	
	T.P. 1	AEC-Q200 REV Dに準拠します。	The measured values
	High	Component shall be soldered on the test board.	
	Temperature	Then it shall be kept in a chamber at +125°C for	
	Exposure	1000 hours. And then it shall be measured after	
	(Storage)	leaving at room temperature for 24 hours. Testing	
		procedure is in accordance with AEC-Q200 REV	
40.0	M NE 41. III		+04 + 11 1 1 1
10-2	低温放置	製品を試験用基板に実装した状態で、温度-55℃の	表 2 を満足します。
		恒温槽中に1000時間保持した後、室温に取り出し、	
		24時間放置した後、測定します。試験方法は	
	0.11	IEC60068-2-1に準拠します。	The measured values
	Cold	Component shall be soldered on the test board.	
	(Storage)	Then it shall be kept in a chamber at -55°C for	
	1000 hours. And then it shall be measured after		
	leaving at room temperature for 24 hours. Testing		
10.0		procedure is accordance with IEC60068-2-1.	+ 6 2 3 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10-3	高温高湿通電	製品を試験用基板に実装した状態で、温度+85℃、	I
		湿度85%R.H.の恒温恒湿槽にD.C.6Vを印加しなが	
		ら1000時間保持した後、室温に取り出し、24時間放	
		置した後、測定します。試験方法はAEC-Q200 REV	
	5	Dに準拠します。	shall meet Table 2.
	Biased Humidity	Component shall be soldered on the test board.	
		Then it shall be kept in a chamber at +85°C,	
		85%R.H. on loading D.C.6V for 1000 hours. And	
		then it shall be measured after leaving at room	
		temperature for 24 hours. Testing procedure is in	
		accordance with AEC-Q200 REV D.	

10-4	熱衝撃	製品を試験用基板に実装した状態で、温度-55℃の	表2を満足します。
		恒温槽中に30分間保持後、温度+125℃の恒温槽中	
		に直ちに移し、30分間保持する。これを1サイクルと	
		し、1000サイクル行った後、室温に取り出し、24時間	The measured values
		放置した後、測定します。試験方法はAEC-Q200	shall meet Table 2.
		REV Dに準拠します。	
	Temperature	Component shall be soldered on the test board.	
	Cycling	After performing 1000 cycles of thermal test (-	
		55°C for 30 minutes to +125°C for 30minutes), it	
		shall be measured after leaving at room	
		temperature for 24 hours. Testing procedure is in	
		accordance with AEC-Q200 REV D.	
10-5	高温通電	製品を試験用基板に実装した状態で、温度+125℃	表2を満足します。
		の恒温槽中にD.C,6Vを印加しながら1000時間保持	
		した後、室温に取り出し、24時間放置した後、測定し	
		ます。試験方法はAEC-Q200 REV Dに準拠します。	The measured values
	Operational Life	Component shall be soldered on the test board.	shall meet Table 2.
		Then it shall be kept in a chamber at +125°C on	
		loading D.C.6V for 1000 hours. And then it shall	
		be measured after leaving at room temperature	
		for 24 hours. Testing procedure is in accordance	
		with AEC-Q200 REV D.	
10-6	耐静電性	下記の回路において、電圧EでコンデンサCに蓄えら	表2を満足します。
		れた電荷を、抵抗Rを介し各端子間に放電した後、	
		測定します。試験方法はAEC-Q200 REV Dに準拠	
		します。	The measured values
	Electro Statics	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	shall meet Table 2.
	Discharge	Component shall be measured after applying	
		surge voltage (E) by discharging capacitor (C)	
		through resistor (R). Testing procedure is in	
		accordance with AEC-Q200 REV D.	
		各端子 - C	
	1	Each terminals	

表1	Table 1.
周波数変動量	±10ppm 以内 (初期値に対し)
Frequency deviation	\pm 10ppm max. (from initial value)
ESR変動量	±20% 以内 (初期値に対し)
Equivalent deviation ∠R/R	$\pm 20\%$ max. (from initial value)

表2 Table 2.

	1 4510 21
周波数変動量	±30ppm 以内 (初期値に対し)
Frequency deviation	\pm 30ppm max. (from initial value)
ESR変動量	±25% 以内 (初期値に対し)
Equivalent deviation ∠R/R	\pm 25% max. (from initial value)

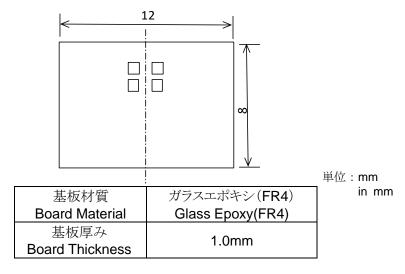


Component mounted/素子実装部

基板材質	ガラスエポキシ(FR4)
Board Material	Glass Epoxy(FR4)
基板厚み	4 6 22 22
Board Thickness	1.6mm

第5図 たわみ試験用基板

Figure 5. Test Board for Bending Strength Test



第6図 試験用基板 Figure6. Test Board

11. 🇘 注意 Cautions

11-1 用途の限定 Limitation of Applications

当製品について、その故障や誤動作が人命または財産に危害を及ぼす恐れがある等の理由により、高信頼性が要求される以下の用途でのご使用をご検討の場合は、必ず事前に当社までご連絡下さい。

- ①航空機器 ②宇宙機器 ③海底機器 ④発電所制御機器 ⑤医療機器
- ⑥輸送機器(自動車、列車、船舶等) ⑦交通用信号機器 ⑧防災/防犯機器
- ⑨情報処理機器 ⑩その他上記機器と同等の機器

Please contact us before using our products for the applications listed below which require especially high reliability for the prevention of defects which might directly cause damage to the third party's life, body or property.

- ①Aircraft equipment
- ②Aerospace equipment
- ③Undersea equipment
- 4 Power plant control equipment
- **5**Medical equipment
- **©**Transportation equipment (vehicles, trains, ships, etc.)
- Traffic signal equipment
- ®Disaster prevention / crime prevention equipment
- Data-processing equipment

11-2 フェールセーフ機能の付加 Fail-safe

当製品に万が一異常や不具合が生じた場合でも、二次災害防止のために完成品に適切なフェールセーフ機能を必ず付加して下さい。

Be sure to provide an appropriate fail-safe function on your product to prevent a second damage that may be caused by the abnormal function or the failure of our product.

12. 使用上の注意 Caution for Use

12-1

過大な機械衝撃が印加された場合、不具合を生じることがありますので取り扱いには充分ご 注意下さい。

The component may be damaged if excess mechanical stress is applied.

12-2

ご使用IC及び発振回路条件により、発振不具合(異常発振あるいは発振停止)が発生する場合がありますので、回路条件を充分ご確認の上ご使用下さい。

Please confirm the circuit conditions on your set, because irregular or stop oscillation may occur under unmatched circuit conditions.

12-3

当製品は、画像認識タイプの位置決め機構実装機に対応しています。但し、実装条件によっては過大な衝撃が加わり製品本体を破損する場合がありますので事前に使用される実装機で必ず評価確認をして下さい。なお、メカチャック機構タイプの実装機での実装は避けて下さい。詳細については事前に当社までお問い合わせ下さい。

The component is recommended with placement machines employing optical placement capabilities. The component might be damaged by mechanical force depending on placement machine and condition. Make sure that you have evaluated by using placement machines before going into mass production. Do not use placement machines employing mechanical positioning. Please contact Murata for details beforehand.

12-4

実装後に基板から取り外した製品は再使用しないで下さい。

Do not reuse components once mounted onto a circuit board.

12-5 はんだ付けに関する注意事項 Caution for Soldering

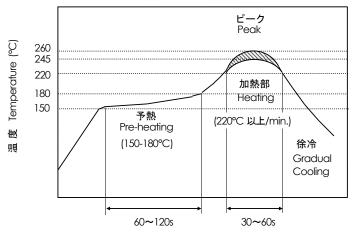
この製品はリフロー方式で実装をお願いします。

Please mount components on a circuit board by the re-flow soldering

12-5-1 推奨するフラックスおよびはんだ Recommendable Flux and Solder

フラックス	ロジン系フラックスをお使いください。水溶性フラックスは使用しないでください。
Flux	Please use rosin based flux, but do not use water soluble flux.
はんだ Solder	Sn-3.0Ag-0.5Cu組成のはんだをご使用ください。 クリームはんだ塗布厚は、0.10~0.15mmの範囲でお願いします。 Please use solder(Sn-3.0Ag-0.5Cu) under the following condition. Standard thickness of soldering paste: 0.10 to 0.15mm

12-5-2 推奨はんだ条件 Recommendable Soldering Profile



	標準プロファイル
	Standard soldering profile
予熱	150°C to 180°C
Pre-heating	60s to 120s
加熱部	220℃ 以上/min.
Heating	30s to 60s
ピーク温度	245℃以上/min. 260°C以下/max.
Peak temperature	5s 以内/max.

^{*}温度は部品表面付近で測定します。

^{*}Temperature shall be measured on the surface of component.

12-5-3 こて付け条件 Reworking with soldering iron

やむを得ずはんだこてを使用して製品をはんだ付け・修正する場合は、以下の点に注意 して行って下さい。

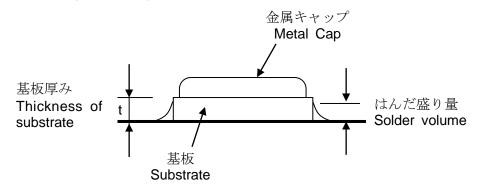
Please solder with soldering iron noting to the following conditions.

	条件
	condition
予熱温度	150°C 60s
Pre-heating	150 C 608
はんだこてのこて先温度	350℃ 以下/max.
Heating of the soldering iron	350 C 以下/illax.
はんだこてのワット数	30W 以下/max.
Watt	50W 以下/illax.
はんだこてのこて先形状	φ3mm 以下/max.
Shape of the soldering iron	φ Sitiiii 💹 [ˈ/itiax.
はんだ付け時間	5s 以内/max.
Soldering Time	55 以内/max.
はんだ	Sn-3.0Ag-0.5Cu
Solder	311-3.0Ag-0.3Cd
	製品に直接こて先がふれないようにしてください。こ
	て先が製品に直接触れて過剰な熱が加わった場合、圧
	電素子の特性劣化や製品電極の破損につながる恐れが
注意事項	あります。
Caution	Please do not directly touch the components with
	soldering iron, because the terminals of components
	or electrical characteristics may be damaged if excess
	thermal stress is applied.

12-5-4 はんだ盛り量 Solder Volume

はんだ盛り量は基板の高さ以下にしてください。基板を超えた場合、キャップと基板の封 止部が破損する可能性があります。

Please keep the solder volume below the height of the substrate. When exceeding the substrate, the damage of sealing part between the metal cap and the substrate may occur.



12-6 製品洗浄に関する注意事項 Caution for washing

塩素系洗浄剤、石油系洗浄剤、アルカリ系洗浄剤での洗浄により不具合が発生することがありますので、ご使用はお避け下さい。

The component may be damaged if it is washed with chlorine, petroleum or alkalicleaning solvent.

12-7 製品コーティングに関する注意事項 Caution for coating

当製品は気密構造ではありません。そのため、樹脂で製品をコーティング/成形することを 保証しておりません。

コーティング樹脂を使用する際は、事前に当社までご連絡ください。

The component is not hermetically sealed. So, it is not guarantee in use case of coating or molding the products with the resin.

Please contact us before using our products with resin coating or molding.

13. 製品保管上の注意 Notice on product storage

13-1

温度-10~+40℃、相対湿度15~85%で、急激な温湿度変化のない室内で保管下さい。

Please store the products in room where the temperature / humidity is stable. And avoid such places where there are large temperature changes. Please store the products under the following conditions : Temperature : -10 to +40 °C

Humidity: 15 to 85% R.H.

13-2

製品保管期限は未開梱、未開封状態にて、納入後6ヶ月間です。納入後6ヶ月以内でご使用下さい。6ヶ月を越える場合ははんだ付け性等をご確認の上、ご使用下さい。

Expire date (Shelf life) of the products is 6 months after delivery under the conditions of an unopened package. Please use the products within 6 months after delivery.

If you store the products for a long time (more than 6months), use carefully because the products may be degraded in the solder-ability and/or rusty. Please confirm solder-ability and characteristics for the products regularly.

13-3

酸、アルカリ、塩、有機ガス、硫黄等の化学的雰囲気中で保管されますとはんだ付け性の劣 化不良等の原因となりますので、化学的雰囲気中での保管は避けて下さい。

Please do not store the products in a chemical atmosphere (Acids, Alkali, Bases, Organic gas, Sulfides and so on), because the characteristics may be reduced in quality, and/or be degraded in the solder-ability due to the storage in a chemical atmosphere.

13-4

湿気、塵等の影響を避けるため、床への直置きは避けて保管下さい。

Please do not put the products directly on the floor without anything under them to avoid damp places and/or dusty places.

13-5

直射日光、熱、振動等が加わる場所での保管は避けて下さい。

Please do not store the products in the places under direct sunlight, heat and vibration.

13-6

開梱、開封後、長期保管された場合、保管状況によっては、はんだ付け性等が劣化する可能性があります。開梱、開封後は速やかにご使用下さい。

Please use the products immediately after the package is opened, because the characteristics may be reduced in quality, and/or be degraded in the solder-ability due to storage under the poor condition.

13-7

製品落下により、製品内部の圧電素子の割れ等の原因となりますので、容易に落下しない状態での保管とお取扱いをお願い致します。

Please do not drop the products to avoid cracking of piezoelectric element.

| |14. *-* ♪お願い Note: 14-1 ご使用に際しましては、貴社製品に実装された状態で必ず評価して下さい。 Please make sure that your product has been evaluated in view of your specifications with our product being mounted to your product. 14-2 当製品を当製品仕様書の記載内容を逸脱して使用しないで下さい。 You are requested not to use our product deviating from this product specification.